部品内蔵技術委員会主催
2024年度第三回公開研究会

主催：部品内蔵技術委員会

◆公開研究会のご案内

研究会テーマ 「部品内蔵・高密度配線板と高速伝送を支える基板材料」

エレクトロニクス実装学会部品内蔵技術委員会（委員長・猪川幸司：C-NET）では、下記要領で2024年度第三回公開研究会を開催致します。今回は、ヘテロジーニアスインテグレーションの実現も含めて応用が拡大する部品内蔵配線板と、今後の5G／6Gに向けた高速伝送を支える基板材料にフォーカスした内容となっています。奮ってご参加下さい。

開催日時　2024年12月19日（木）　13：10～17：10

開催方式　現地開催＆WEB (Zoom Webinarシステム利用）ハイブリッド

開催場所：　回路会館地下1F会議室

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

★★★最初の講演【特別講演】が変更になりました★★★

13：10～13：15

オープニング

開会挨拶　部品内蔵技術委員会技術調査研究会　　藤村　迅　主査

13：15～14：00

特別講演 「次世代パワー半導体と部品内蔵技術」

ローム株式会社　　梅本　清貴　氏 【WEB講演】

＜概要＞ロームが取り組む次世代パワー半導体であるEco SiC、Eco GaNを搭載した部品内蔵技術を用いた製品例を紹介する。ディスクリート品以外になぜ部品内蔵技術を用いた製品が必要なのかを技術的視点を交えながら講演する。

14：05～14：35

講演 「ヘテロジニアスインテグレーション向け、再配線層内蔵コアレス基板（有機インターポーザー）のご紹介」

TOPPAN株式会社　　高城　総夫氏 【現地講演】

＜概要＞半導体の高機能化において、インターポーザー上に異種複数チップを集積するヘテロジニアスインテグレーションが主流となっています。インターポーザーには、接続の信頼性から、チップの熱膨張係数(CTE)に近づける低CTE化、IO(入出力)数増大による微細接続、搭載チップ数増大による大型化が要求されています。TOPPAN が開発したシンプルなコアレス構造の有機インターポーザーを紹介します。

14：40～15：25

講演 「AI・6G・光・テラヘルツに対してプリント配線板に求められる材料について」

OKIサーキットテクノロジー株式会社　　飯長　裕　氏 【現地講演】

＜概要＞光に移行する中で、データー転送は、200Gを目指す勢いであり、それに対応するプリント配線板が必要となる。重要な要素である、材料について、各社の対応について報告する。

（休憩10分）

15:35～16:20
講演「高周波対応BTレジン積層材料の開発動向」
三菱ガス化学株式会社　山本　克哉　氏【現地講演】

＜概要＞情報通信の高速化・大容量化に伴い、電子機器で使用する電気信号の高周波数化が年々進行している。当社では独自技術であるBTレジンのユニークな特性を活かし、半導体業界のトレンドに適合した開発品を創出してきた。本講演では、電気信号の劣化を抑制するために伝送損失をPTFE材同等まで低減した低誘電積層材料や、アンテナサイズを小型化するための高誘電積層材料などの次世代BTレジン積層材料の開発動向を紹介する。。

16:25～17:10
講演「高速高周波用プリント基板材料の開発動向」
AGC株式会社　森野　正行　氏【現地講演】

＜概要＞高速高周波用基板材料に注目が集まる中、特にフッ素樹脂は良好な誘電性能を持つ一方で、他材料との複合化に困難があった。また基板の特性調整にフィラー材料が用いられるが、低誘電、高機械強度、良分散性を備えた材料が求められている。AGCでは独自技術により、前記の要求性能を備えた接着性フッ素樹脂〈Fluon+TM EA-2000〉と〈低誘電シリカフィラー〉を開発した。これらを他材料と複合化することで、高周波帯に適した基板の実現が可能となる。

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

参加要項

定　　員　回路会館地下1F会議室：50名(先着申込順　定員になり次第締め切ります)
　　WEB (Zoom Webinar)：200名(先着申込順　定員になり次第締め切ります)

参 加 費(消費税込み)
正会員：5,000円、 学生会員：1,000円、 研究会会員：別払い、 シニア会員：2,000円
名誉会員：無料、 賛助会員の社員：5,000円、 賛助会員(クーポン利用)：無料
非会員一般：15,000円、 非会員学生：2,000円、 協賛団体（JPCA会員）:5,000円

注意事項(参加方法)

①申込が受理されますと、**返信メールで 公開研究会への参加　URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
　（お支払い方法：クレジットカード決済またはコンビニ決済のみ）（手数料学会負担）
③**領収書(宛名会社名選択可)**のご発行は、返信メールのマイページから**決済後に即日出力が可能**です。
④WEBの領収書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで（複数口の場合は口数分）利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。
＊キャンセルポリシー
　お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員　**賛助会員**　**協賛会員**　**非会員**

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先　　一般社団法人エレクトロニクス実装学会
E-mail：info¥jiep.or.jp（メールアドレスは¥を@に置き換えてください）